

中期経営計画 (2025-2027年度)

2025/05/09

株式会社東京精密

代表取締役会長CEO 吉田 均

代表取締役社長COO 木村 龍一

代表取締役副社長 CFO 川村 浩一

- 将来の事象に係わる記述に関する注意：** 本資料に記載されている情報、ならびに口頭で提供される情報は、現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。これらは、市況、競争状況、半導体業界、ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、今後の当社の実際の業績が、本資料に記載されている情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。
- 用語について：** 注記がある場合を除き、半導体製造装置セグメントを「半導体」、精密計測機器セグメントを「計測」、また親会社株主に帰属する当期純利益を「当期純利益」と記載します。
- 記入データについて：** 記載されている金額や比率の情報は「億円」、またはパーセント(%)による要約表示を行っております。その為、内訳の計が合計と一致しない場合があります。
- 監査について：** 本プレゼンテーション資料は、監査法人による監査の対象外です。

アジェンダ

- 前中期経営計画 振り返り
- パーパス・長期ビジョン
- 中期経営計画(2025-2027年度) 位置づけ・基本方針・定量目標
- 中期経営計画(2025-2027年度) セグメント別事業機会
- 中期経営計画(2025-2027年度) サステナビリティマネジメント

アジェンダ

- 前中期経営計画 振り返り
- パーパス・長期ビジョン
- 中期経営計画(2025-2027年度) 位置づけ・基本方針・定量目標
- 中期経営計画(2025-2027年度) セグメント別事業機会
- 中期経営計画(2025-2027年度) サステナビリティマネジメント

前中期経営計画 振り返り- 定量目標

民生アプリケーション需要が想定以上に停滞、売上高・営業利益(率)は定量目標に未達

ROEは3年平均で目標の15%を達成

売上高・純利益は2024年度、営業利益は2022年度に既往ピークを更新

| | 2021年度 実績 ^(*) | 2022-2024年度 中期経営計画 定量目標 | 2022年度 実績 | 2023年度 実績 | 2024年度 実績 |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 売上高 | 1,307億円 半導体1,011億円 計測296億円 | 1,700億円 半導体1,320億円 計測380億円 | 1,468億円 半導体1,124億円 計測344億円 | 1,346億円 半導体1,001億円 計測346億円 | 1,505億円 半導体1,135億円 計測371億円 |
| 営業利益 | 285億円 半導体247億円 計測36億円 | 375億円 | 345億円 半導体299億円 計測46億円 | 253億円 半導体199億円 計測54億円 | 297億円 半導体243億円 計測54億円 |
| 営業利益率 | 22% 半導体24% 計測12% | 22% | 23% 半導体27% 計測13% | 19% 半導体20% 計測16% | 20% 半導体21% 計測15% |
| ROE | 17% | 15%以上 | 3年平均 15% ^(*) | | |

| 総括 |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● 半導体売上高： 民生需要の伸び悩みを主因に定量目標を下回ったが、生成AI(ロジック・HBM等)を含むHPC、中国需要などで、既往ピークを更新 ● 計測 売上高： ものづくり市場、NEV需要共に軟調ななか、成長業界への販売多角化や製品価格改定で増収、既往ピークを更新 ● 営業利益： 売上増加により2022年度に既往ピーク更新し利益率も目標達成したが、部材調達コストや経費の上昇による下押し圧力が高まる ● ROE：3年平均ROE15%を達成 |

(*) 2022年度より、在外子会社の収益及び費用は、期末レートから期中平均レートにより円換算する方法に変更しております。

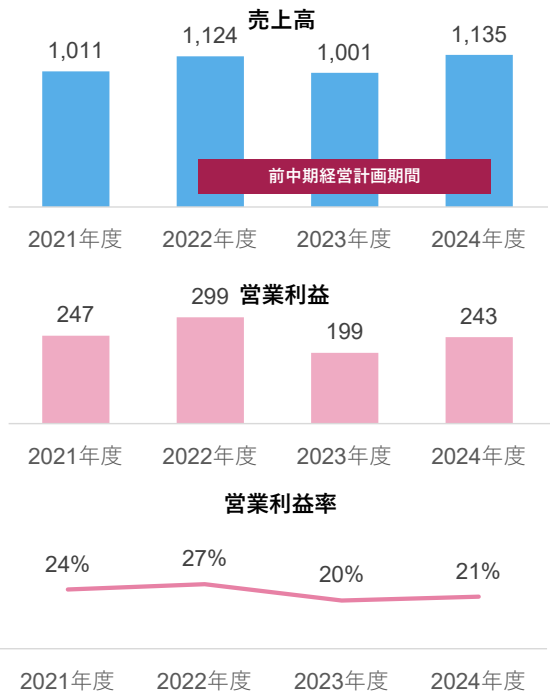
これに伴い、本資料に掲載の2021年度の数値は、期中平均レートを遡及適用した数値を記載しております。

(*) 3年平均ROE = 親株主に帰属する当期純利益(2022-2024年度単純平均) ÷ 自己資本(2021-2024年度単純平均) で算出

前中期経営計画 振り返り - 半導体製造装置

2024年度に売上ピーク、2022年度に利益ピークを更新

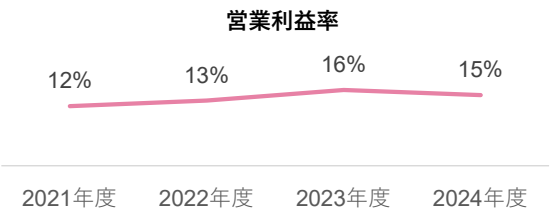
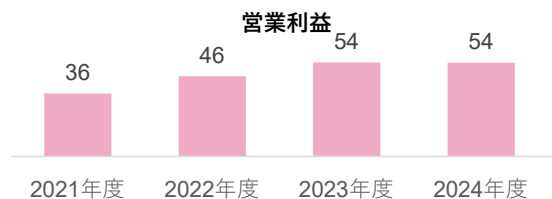
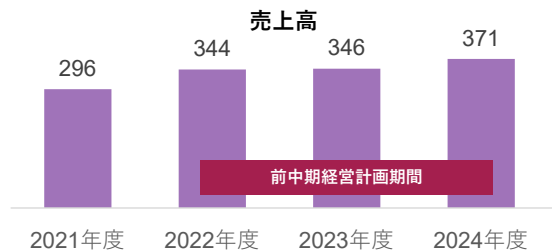
半導体デバイスの高機能化や複雑化は一定の事業機会となったが、個数成長やSiC需要は限定的にとどまった



| 前提 | 当社の事業機会 | 振り返り |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● 半導体デバイスの高機能・複雑化 ● 高信頼性デバイスの増加 | <ul style="list-style-type: none"> ● 検査の重要性が増す ● 測定時間延伸 ● 測定条件の広がり | <ul style="list-style-type: none"> ● 検査重要性が増加 ● 測定時間が延伸 (微細化, ビット成長, テスト数増) ● 高精度温度制御が注目技術に |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 安定した半導体個数成長 (大量生産・大量消費) | <ul style="list-style-type: none"> ● 積層・パッケージングの進化 | <ul style="list-style-type: none"> ● AI中心にパッケージング需要が増加し、加工装置に恩恵 ● 検査需要も増加 |
| <ul style="list-style-type: none"> ● カーボンニュートラルに向けたSiC/GaN パワー半導体の革新 | <ul style="list-style-type: none"> ● 市場そのものの拡大 ● 新たな加工プロセス構築 ● 信頼性重視の検査 | <ul style="list-style-type: none"> ● 民生アプリケーション停滞 想定市場より弱い推移 |
| <ul style="list-style-type: none"> ● デバイス検査・加工精度要求の高まり | <ul style="list-style-type: none"> ● 当社計測機器とのシナジー | <ul style="list-style-type: none"> ● 一定の需要獲得も 2024年度以降は減速基調 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ● プローバ+光計測、ダイサ+光計測の新製品を展開 |

前中期経営計画 振り返り – 計測機器

ものづくり市場の新規投資が限定的、かつNEVへの移行がスローダウンする中、対象市場の拡大、充放電試験システムの展開などを通じて3期連続増収



| 前提 | 当社の事業機会 | 振り返り |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● カーボンニュートラルに向けたNEV・再エネ市場拡大 | <ul style="list-style-type: none"> ● NEV化による素材/部品の変化 ● 高精度測定需要の増加 ● NEVなどのバッテリー測定 | <ul style="list-style-type: none"> ● NEVへの移行が想定より緩慢 ● 充放電試験システムの事業機会増 |
| <ul style="list-style-type: none"> ● ものづくり自動化の流れ | <ul style="list-style-type: none"> ● ロボットと測定機の組合せ ● 高精度部品の全数測定 | <ul style="list-style-type: none"> ● 一定の需要獲得 ● 今後の市場拡大に期待 |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 非自動車分野のものづくり拡大 (半導体・航空宇宙・ロボット) | <ul style="list-style-type: none"> ● 半導体向け (非接触) ● 航空・宇宙基幹部品 (高精度) ● 協働ロボット向け | <ul style="list-style-type: none"> ● 各分野で事業機会を獲得 ● 政府の補助金政策も後押し |

前中期経営計画 振り返り - 主な取り組み

概ね 計画通りの成果となり、次期中期経営計画の基盤を構築した

| 項目 | 取り組み内容 | 主な成果 |
|--------------------|--|---|
| 研究開発投資 | <ul style="list-style-type: none">● 先端技術、顧客ニーズ対応開発を強化 | <ul style="list-style-type: none">● 試験研究費総額 279億円● 中期経営計画(2025-2027年度)の中核製品を開発・展開<ul style="list-style-type: none">➢ 高精度温度制御プローバ➢ ハイエンドグラインダ➢ 二次電池用充放電試験システム |
| 生産キャパシティ拡充 | <ul style="list-style-type: none">● 飯能工場稼働 | <ul style="list-style-type: none">● 設備投資総額 316億円● 半導体生産キャパシティ1,400億+α/年の水準を達成<ul style="list-style-type: none">➢ 飯能工場(埼玉県)稼働➢ 八王子工場リノベーション● 名古屋工場 着工 (2025年7月竣工予定) |
| 環境投資 | <ul style="list-style-type: none">● 2030年CO2排出量 50%削減(2018年度比)に向け、必要な投資を検討 | <ul style="list-style-type: none">● 主要工場でCO2フリー電力導入, 効率化投資を実行● 既存工場^(*1)でのCO2排出量を 2018年度比 約40%削減 |
| 投資評価指標 | <ul style="list-style-type: none">● 社内評価基準にROICを検討 | <ul style="list-style-type: none">● 2022年度より事業セグメント別ROIC評価を開始 |
| アプリケーション強化 | <ul style="list-style-type: none">● 各国拠点におけるデモ設備強化 | <ul style="list-style-type: none">● 5拠点で設備新設または評価装置のラインナップ増強 |
| 非財務 (ESG取り組み強化) | <ul style="list-style-type: none">● ESG各取り組み強化 | <ul style="list-style-type: none">● 人権活動・サプライチェーンCSR活動の強化● 人的資本への取り組み強化● ESGスコア上昇 (MSCI: BB → A、FTSE 3.1 → 3.57) ^(*2) |

(*1) 対象：東京精密単体の工場設備(2023年度竣工の飯能工場、2024年度移管の古殿工場を除く)

(*2) 2022年6月から2024年6月の変化

アジェンダ

- ・ 前中期経営計画 振り返り
- ・ **パーパス・長期ビジョン**
- ・ 中期経営計画(2025-2027年度) 位置づけ・基本方針・定量目標
- ・ 中期経営計画(2025-2027年度) セグメント別事業機会
- ・ 中期経営計画(2025-2027年度) サステナビリティマネジメント

東京精密のパーパス

創業時から受け継ぐ「技術を突き詰め、技術革新を成し遂げる土壌」を継承し
世界中の技術・知恵・情報の融合で、「夢のある未来」の実現を目指す

Purpose

パーパス

計測で未来を測り、半導体で未来を創る

精密測定機器事業からスタートした当社グループは、高い計測技術を搭載した精密測定機器を産業界に提供し、半導体製造装置事業においても高度な微細化と3D、高効率化への対応に計測技術を活かしてきました。「計測事業を持つ唯一の半導体製造装置メーカー」という特徴は、当社グループの強みの源泉となっています。

ビジョン

東京精密グループは“夢のある未来”を築く一員であり続けます。

ミッション

- 世界中の優れた技術・知恵・情報を融合して世界No.1の商品を創り出し、皆様と共に大きく成長していく
- WIN-WINの仕事で世界No.1の商品を創ろう

バリュー

お客さま、株主の皆さま、サプライヤーさま、従業員、地域社会、国際社会など全てのステークホルダーとの間でWIN-WINの関係を創りあげ、持続可能な社会の実現に向け積極的に役割を果たすとともに、企業価値の向上に努めます。

企業文化

技術を突き詰め、
技術革新を成し遂げる土壌

コア技術

精密に測る力

東京精密グループ長期ビジョン2050

東京精密グループ長期ビジョン2050

高度な技術力と豊かな創造性で未体験の未来を切り拓く



革新的な半導体製造プロセスを実現する
最先端の製造装置を開発

次世代デバイス製造に向けた高精度な加工技術

最先端デバイス製造を支える高度な測定技術

前・中・後工程 トータルソリューション

各事業のありたい姿

今後10年で獲得・強化

中期経営計画(2025-2027年度)
持続的成長に向けた 足場固め・インフラ作り

“モノづくり革新”に欠かせない
精密測定機器・サービスの提供

二次電池関連ビジネスの強化

サイバー・フィジカル・エンジニアリングへの対応

計測・検査サービスの拡大 (モノ売り→コト売り)

新規事業創出に向けた研究・開発の強化

“半導体×精密測定”のシナジーを活かした製品

新素材・化学に対応する独自技術

産学連携での新領域探索

環境に配慮した製品・素材

経営基盤強化

デジタル技術を活用した事業改革

新製品・事業創造に向けたグランドデザインを描く組織体制の構築

変革を支える企業文化の醸成

アジェンダ

- ・ 前中期経営計画 振り返り
- ・ パーパス・長期ビジョン
- ・ **中期経営計画(2025-2027年度) 位置づけ・基本方針・定量目標**
- ・ 中期経営計画(2025-2027年度) セグメント別事業機会
- ・ 中期経営計画(2025-2027年度) サステナビリティマネジメント

中期経営計画(2025-2027年度)の位置づけ

中期経営計画(2025-2027年度)では、「長期成長に向けた準備」と「期間の成長」とを両立する

2022-
2024年度
(前回)

次の成長の為の布石置き

- 研究開発投資
- 生産キャパシティ拡張
- アプリケーション強化
- 環境投資

2025-
2027年度
(今回)

持続的成長に向けた
足場固めとインフラ作り

- 戦略製品の成長促進
- 半導体・計測のシナジー追及
- リカーリングビジネス拡大
- 生産キャパシティ投資
- アプリケーション強化投資
- 新事業創設への始動

~2035年度
(10年後)

当社製品・サービスが無ければ
「モノを作れない・測れない」
絶対的なポジション確立

- 次世代・最先端デバイスに向けた高精度な加工・測定技術の提供
- シナジーが生み出す唯一無二の技術の確立
- 顧客のあらゆる課題に対するソリューションの提供

中期経営計画(2025-2027年度)の基本方針

事業強化と事業基盤そのものの強化を両立させる

戦略製品の成長促進

- 半導体製造装置：
 - 高付加価値プローバ
 - 先端グラインダ
 - 先端ダイサ等
- 計測機器：
 - 充放電試験システム
 - X線検査装置等

計測・半導体の技術シナジー追求

- 精密計測機器をビルトインした新たな半導体製造装置
- 計測アプリケーションの半導体エリアへの応用

リカーリングビジネス強化

- 半導体製造装置：
 - サービス/サポートビジネス強化
 - 消耗品事業拡大
 - 既設装置向け事業機会創出
- 計測機器：
 - 受託計測・評価サービス拡充
 - 機器校正サービス強化

これらを支える事業基盤の強化

要素技術開発の強化促進

セグメント横断的な事業戦略組織

新たなチャレンジを促す環境

ITを活用した生産性向上

サステナビリティ
マネジメントの進化

東京精密マテリアリティ（重要課題）

長期ビジョンの実現に向けて取り組むべきマテリアリティを特定し、新中期経営計画の戦略・施策へと展開

豊かな社会の実現に貢献

未来を創り社会を豊かにする半導体製造への貢献
精密測定を通じたモノづくりイノベーションへの貢献

持続可能な社会への貢献

温室効果ガス削減
地球環境に貢献する製品

ステークホルダーからの信用・信頼

バリューチェーンのサステナビリティ推進
品質と安定供給の確保、カスタマーサポートの充実

職場づくり

多様性・健康で安全な職場・
従業員エンゲージメントの向上

ガバナンス強化

コンプライアンスの強化
リスクマネジメントの推進

事業基盤の強化

人財育成・開発力強化・DX推進・
変革を支える企業風土・安定経営

中期経営計画(2025-2027年度) 定量目標

2024年度実績に対し、約20%増収、50%増益の目標を設定

| | 2024年度 実績 | 中期経営計画期間 (2025-2027年度) 単年度 |
|-------|---|---|
| 売上高 | 1,505億円 半導体1,135億円 計測371億円 | 1,850億円 半導体1,400億円 計測450億円 |
| 営業利益 | 297億円 半導体243億円 計測54億円 | 450億円 |
| 営業利益率 | 20% 半導体21% 計測15% | 24% |
| ROE | 15% | 15% |

前提

- 定量目標：単年目標として設定(市場ボラティリティを考慮)
- 半導体：対象市場のCAGR前提 +5%をアウトパフォーム
- 計測：非自動車(半導体, 航空, 宇宙など)の持続的な市況回復
- 営業利益：売上増(高付加価値製品を含む)
原価低減の進展、リカーリングビジネス推進
- ROE：純利益の積み増し
- リスクファクター：
 - 民生アプリケーション需要の不確実性
 - 地政学リスク(中国の装置需要・競合等)
 - 工作機械受注の鈍化

キャッシュアロケーション

研究開発・設備投資・株主還元のバランスをとる

研究開発投資

開発強化、3年累計で350～400億円を想定

戦略製品開発、要素技術開発、計測と半導体のシナジー技術開発
他社との共同研究開発の推進 等

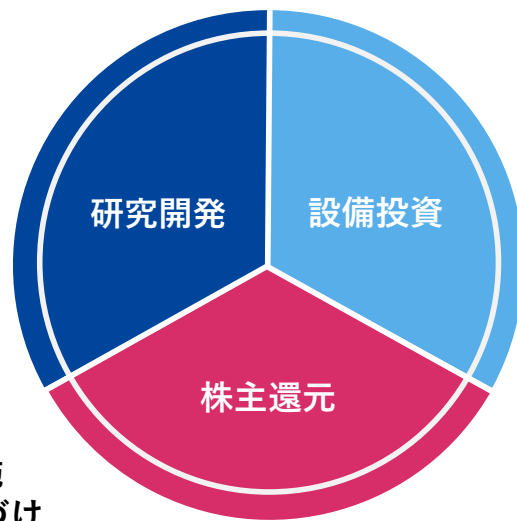
設備投資

将来を見据え、3年累計で累計300～400億円^(*)を想定

- 成長投資：名古屋工場、八王子新工場(2025年度用地取得)、韓国デモセンター新設、二次電池評価機能拡張等
- 事業基盤強化：IT強化、業務効率化、ESG関連投資

株主還元

配当による利益配分を基本に、連結配当性向40%を目安として実施
自己株式取得は 剰余金配当を補完する機動的な利益還元策と位置づけ



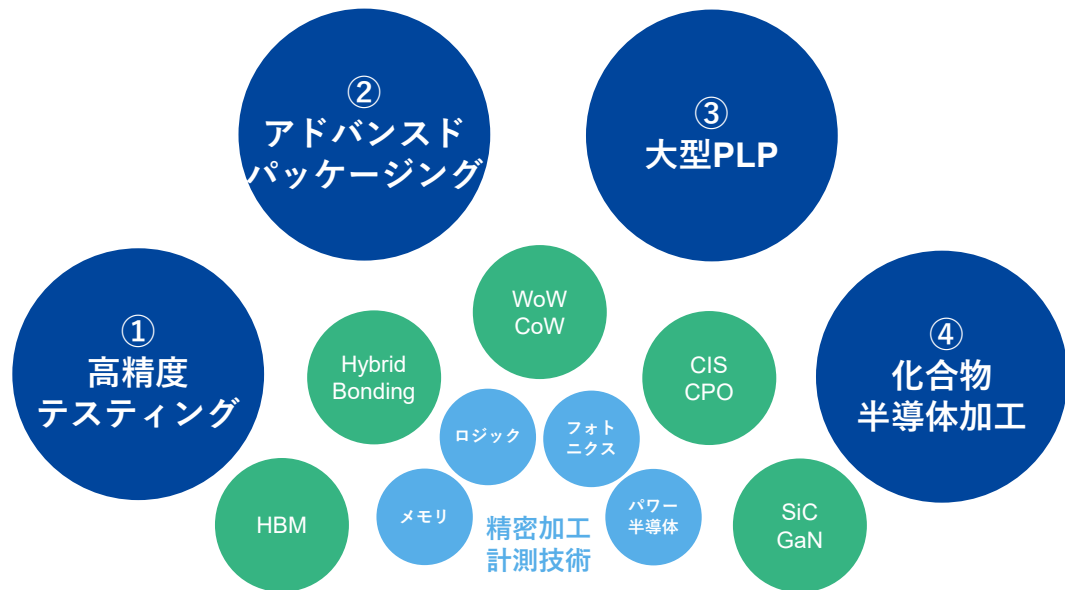
(*1) 工事進捗により変動

アジェンダ

- ・ 前中期経営計画 振り返り
- ・ パーパス・長期ビジョン
- ・ 中期経営計画(2025-2027年度) 位置づけ・基本方針・定量目標
- ・ **中期経営計画(2025-2027年度) セグメント別事業機会**
- ・ 中期経営計画(2025-2027年度) サステナビリティマネジメント

セグメント別事業機会：半導体

テスト・加工領域の技術進化は著しい
最先端の技術要求に応える製品の提供を続け、高付加価値を提供する



① 高精度テスト

- テスト時の高精度温度制御対応

② アドバンスドパッケージング

- 高品質ダイシング
- 研削工程増加・
ハイエンドグラインダ要求
- チップ員数増によるテスト要求拡大
- 高精度エッジトリミング

③ 大型PLP

- 大型基板研削・切断
- PLPダイレクトプロービング

④ 化合物半導体加工

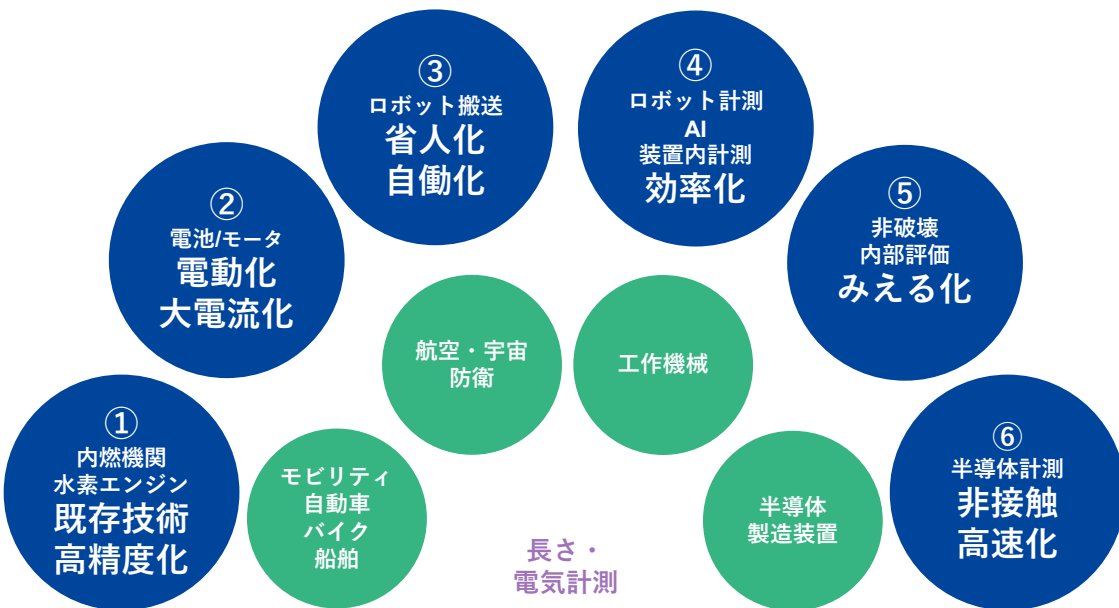
- ノンシリコン基板の研削

(注) CPO: Co-packaged Optics, WoW : Wafer on Wafer, CoW : Chip on Wafer, HBM: High Bandwidth Memory

セグメント別事業機会：計測機器

測定ニーズが今まで以上に広がりを見せている

当社は汎用計測・自動計測・充放電試験システムのソリューションを拡大し、様々な計測ニーズに応え 業容を拡大する



① 既存技術の高精度化

- ・ ハイエンドCMMの必要性

② 電池/モータの電動化・大電流化

- ・ 低電流～大電流への移行による機器の交換
- ・ 二次電池受託評価

③ 省人化・自動化

- ・ 加工機/測定機間の自動搬送・自動測定

④ 効率化

- ・ 「現場での測定」ため 測定機要求の変化
- ・ 工作機械加工の常時監視

⑤ 見える化

- ・ X線CTによる内部観察・欠陥検出需要

⑥ 非接触・高速化

- ・ 非接触での表面形状測定
- ・ 半導体デバイス・製造装置部品の測定
- ・ 半導体製造装置へのビルトイン

(注) CMM: Coordinate Measuring Machine, (3次元)座標測定機、CT: Computed Tomography, コンピュータ断層撮影

アジェンダ

- ・ 前中期経営計画 振り返り
- ・ パーパス・長期ビジョン
- ・ 中期経営計画(2025-2027年度) 位置づけ・基本方針・定量目標
- ・ 中期経営計画(2025-2027年度) 事業別戦略
- ・ 中期経営計画(2025-2027年度) **サステナビリティマネジメント**

事業を支える基盤

“事業の発展を下支えする要素として重要視するもの”への取り組みを深める

要素技術開発の 強化促進

- 事業部門間の技術交流によりイノベーションを促進
- 産官学連携の深化を通じた要素技術開発力の高度化
- 次世代技術の開拓

セグメント横断的な 事業戦略組織

- 計測機器の半導体製造装置への搭載推進
- 技術融合による「当社独自の付加価値」、「差別化」の追求
- 全社的組織により新事業立案の推進

新たなチャレンジを 促す環境

- 技術スキルセットの明確化、新技術習得へのモチベーション向上
- イノベティブなアイデアを養う教育の実施
- 若手社員がチャレンジできる場の創出

ITを活用した 生産性向上

- ITを活用した業務の高度化・効率化の推進
- 生産システム高度化による生産性向上
- グローバルITインフラ共通化による情報共有推進

サステナビリティマネジメントの深化

事業の発展と不可分なESG経営を実践してゆく

E

カーボンニュートラルに
向けた企業活動の推進

- 自社製品・サービスの提供を通じた環境負荷の低減
- 事業活動におけるGHG排出量の削減
- サステイナブル調達活動の推進

S

人を活かし
社会からの信頼を高める
企業姿勢の強化

- 従業員が心身の健康を保ち、能力を最大限に発揮できる職場環境の構築
- 従業員エンゲージメントの向上による、仕事意欲向上と組織一体感の強化
- 高品質な製品・サービスの提供による顧客満足度の向上

G

公正な企業活動の
基盤となる
ガバナンスの強化

- グループ全体での高い企業倫理・遵法精神の育成
- 適時・適切な情報開示の推進
- リスクマネジメントの強化

質疑応答 / Q&A

(ご参考) 東京精密 マテリアリティ

| テーマ (合計 6テーマ) | マテリアリティ (合計 23マテリアリティ) |
|------------------------------|--|
| 豊かな社会の実現に貢献 | 社会課題を解決する製品の創出と提供 未来を創り社会を豊かにする半導体製造への貢献 精密測定を通じたモノづくりのイノベーションへの貢献 |
| 持続可能な社会づくりに貢献する事業活動の推進 | バリューチェーンにおける温室効果ガスの削減 地球環境に貢献する製品の創出と提供 環境保全と資源管理の最適化 サーキュラー・エコノミーの実現 環境マネジメントシステムの高度化 |
| ステークホルダーの信用・信頼に応える企業姿勢の維持・強化 | バリューチェーンにおけるサステナビリティの推進 製品品質と安定供給の確保及びカスタマーサポートの充実 ステークホルダーエンゲージメントの推進 |
| 多様な人々が前向きに活々と働ける職場環境の醸成 | 多様性・公平性・包摂性 (DE&I) の推進 心身ともに健康で安全に働ける職場づくり 従業員エンゲージメントの向上 |
| 公正な企業活動の基盤となるガバナンスの強化 | コーポレート・ガバナンスの強化 コンプライアンスの強化 リスクマネジメントの推進 |
| 事業基盤の強化 | 人財育成の推進 研究開発力の強化 知的財産の管理と活用 DXの推進 変革を支える企業風土の醸成 持続可能な安定経営の実現 |